DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04367828

Image available

LIOUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

PUB, NO.:

06-011728 [JP 6011728 A]

PUBLISHED:

January 21, 1994 (19940121)

INVENTOR(s): KOBAYASHI MICHIYA

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

04-170761 [JP 92170761]

FILED:

June 29, 1992 (19920629)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1726, Vol. 18, No. 211, Pg. 70, April

14, 1994 (19940414)

ABSTRACT

To provide the liquid crystal display device having high brightness and good display grade by forming the upper layer of a light shielding film as an oxidized insulating film.

CONSTITUTION: The upper layer part of the light shielding film 23 is anodically oxidized to form the insulating film 25, by which the insulating film 25 and its through-holes 17, 21, etc., are formed with good dimensionally accuracy without using a photolithographic stage and, therefore, the process for production is simplified and the opening rate of picture element parts is increased. The insulating film formed by the anodic oxidation method has extremely few pinholes and, therefore, the danger of the electrical contact between pixel recording mediums 27 formed on this insulating film 25 and the light shielding film 23 of the lower layer of this insulating film is decreased.

(19)日本国特許庁(JP)

G 0 2 F 1/138

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-11728

(43)公開日 平成6年(1994)1月21日

(51)Int.CL*

識別配号 500 庁内整理番号 9018-2K FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-170761

(22)出顧日

平成 4年(1992) 6月29日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 小林 道欽

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

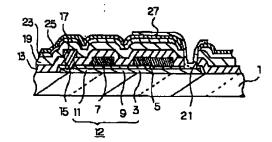
(74)代理人 弁理士 須山 佐一

(54)【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 輝度が高く表示品位の良好な液晶表示装置を 提供する。

【様成】 遮光膜23の上層部分を陽極酸化して絶縁膜25とすることにより、絶縁膜25およびそのスルーホール17、21などをフォトリソグラフィ工程を用いずに寸法精度よく形成できるので、製造工程を簡易化することができ、かつ画素部分の開口率を向上することができる。また陽極酸化法により形成された絶縁膜はビンホールが極めて少ないので、この絶縁膜25の上層に形成される画素電極27とこの絶縁膜の下層の遮光膜23との電気的接触の危険性を低減させることができる。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に複数の走査配線および複数の信 号配線と、該走査配線および信号配線に接続されるスイ ッチング素子と、該スイッチング素子に接続される画素 電極と、前配画素電極を避けて配設され前記スイッチン グ素子に入射する光を遮る遮光膜とを有するスイッチン グ索子アレイ基板と、前記スイッチング素子アレイ基板 に対向して間隙を有して配置される対向電極が配設され た対向基板と、前記スイッチング素子アレイ基板と前記 表示装置において、

1

前記遮光膜が金属材料からなり、前記遮光膜の上層を酸 化してなる絶縁膜を具備することを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項2】 基板上に複数のゲート配線と複数の信号 配線と該ゲート配線および信母配線に接続するスイッチ ング素子と、該スイッチング素子に接続する画素電極と を配設し、前記画素電極を避け、かつ前記スイッチング 素子に入射する光を遮るように遮光膜を配設し、前記遮 を形成し、これを対向電極と組み合わせてその間隙に液 晶組成物を封入して挟持させ、液晶表示装置を製造する にあたり、

金属材料を成膜して前記遮光膜を形成し、

前記遮光膜の上層を陽極酸化により酸化して絶縁膜を形 成するととを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は遮光膜を有する液晶表示 装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置の表示の高品位化、高速駆 動化には、各表示画素ごとにスイッチングトランジスタ を設けたアクティブマトリックス型液晶表示装置が好適 なものとして広く知られている。スイッチングトランジ スタには非晶質シリコン(以下a-Siと略称)、また は多結晶シリコン(以下poly-Siと略称)による 薄膜トランジスタ (TFT) を用いるのが一般的であ

板上に大面積にわたって形成が可能な特長を有すること から、壁掛けテレビや〇A用ディスプレイなどの大型画 面の液晶表示装置に好適である。

【0004】一方poly-SiによるTFTは、キャ リアの移動度が数10乃至 200c m³/V s と比較的大き いので、TFTサイズが小さくても液晶表示素子の画素 を駆動するスイッチング素子としては十分な機能を有 し、周辺駆動回路も同一基板上に一体で形成できるため 装置全体を小型化することができるので、プロジェクシ ョンテレビやビデオカメラのビューファインダといった 50 ずれを吸収するために、ブラックマトリックスの開口寸

小型で高精細であることが要求される液晶表示装置に好 適である。

【0005】図3 (a) はpoly-SiによるTFT を用いた従来の液晶表示装置のTFT基板側の表示画素 部分を示す平面図、図3(b)はそのA-B断面図であ る。TFT301は、第1のpoly-Siによる活性 層303と、ゲート絶縁膜305、低抵抗の第2のpo 1y-Siによるゲート307からなる。ゲート307 両側の部分はTFT301のソース309・ドレイン3 対向基板との間に封入される液晶組成物とを有する液晶 10 11であり、n型ドーパントであるP(燐)が打ち込ま れて低抵抗となっている。上記ドレイン311は層間絶 縁膜313を挟んでAlからなる信号線315に接続さ れており、上記ゲート307は第2のpoly-Sik よるゲート線317と一体である。上記ソース309 は、層間絶縁膜313を挟んで、1TOからなる画素電 極316と接続されている。さらに上記ソース308は 蓄積容量319に接続されている。蓄積容量319は、 MOS容量であり、その下地部分321は第1のpol y-SiからなりTFT301の活性層303と一体で 光膜上に絶縁膜を配設してスイッチング素子アレイ基板 20 あり、ゲート絶縁膜305と同時に形成される絶縁膜3 23を挟んで、上部には第2のpoly-Siによる蓄 積容量線325がある。

> 【0006】図4は、上述の表示画素が形成されたTF Tアレイ基板401と対向基板403を示す一部省略斜 視図である。対向基板403には、マトリックス配置さ れたいわゆるブラックマトリックス (あるいはブラック マスク)と呼ばれる遮光膜405とITOのような透明 電極からなる対向電極(図示省略)が形成されている。

通常、ブラックマトリックスとしての遮光膜405 30 は、TFTアレイ基板401に形成されているゲート線 317、信号線315、TFT301を覆い隠し、画素 電極316の部分のみ開口を設けるような形状に配設さ れている。TFT301は活性層がa-Siであるかp oly-Siであるかを問わず、光が照射されるとOF F電流が増大して誤動作することがあるので、このよう なTFTの誤動作の原因となる入射光を遮るために遮光 膜が必要である。とのような構成の従来の液晶表示装置 においては、TFTアレイ基板401と対向基板403 とを組立てる際に高精度の位置合わせが必要である。す 【0003】a-SiによるTFTは、安価なガラス基 40 なわち、TFTアレイ基板401と対向基板403とを 組み合わせて配置する際の位置ずれにより、例えば画素 電極316と信号線315との間の間隙部分が遮光膜4 05の閉口部分にはみ出すと、前記間隙では液晶が駆動 されないため、例えばTN型液晶を用いたノーマリホワ イトモードの液晶表示素子の場合では、その部分に光が 常時通過し表示画素のコントラスト比が低くなるためで ある。

> 【0007】そこでこのようなTFTアレイ基板と対向 基板との位置合わせずれに起因する遮光膜405の位置

法にそのずれの寸法程度のマージンを取り面積を小さく すればよい。しかしながら、このような方法では画素電 極316の画素表示にあたる部分の開口率が小さくな り、画面の輝度が低下するという問題がある。一方、位 置合わせ精度自体を向上させることも考えられるが、実 際にはTFTアレイ基板401と対向基板403との位 置合わせ精度は画面サイズにもよるものの、例えば対角 5インチ前後のサイズのもので通常士 2μm程度、10イ ンチ級のサイズでは± 3μπ程度でまでが可能な範囲で である。したがって従来の技術においては、遮光膜の画 素電極とのオーバラップ部分は数μm程度、すなわち上 記の合わせ精度程度は取るように設計されている。

【0008】さらに、TFTアレイ基板と対向基板とで はその製造プロセスの熱履歴が異なる。poly-Si を用いたTFTアレイ基板では最高1000°C程度、a-S iを用いたTFTアレイ基板では最高 350℃程度にまで 加熱する工程があるのに対し、対向基板では最高 200°C 程度までの加熱工程である。したがって、TFTアレイ が異なり、両基板上のパターンにピッチずれが生じると いう問題がある。これを吸収するためには遮光膜の閉口 部分の寸法にマージンをさらに大きく取らねばならない が、そのようにすると越光膜の閉口面積はさらに小さく なり、画面の輝度がさらに低下するという問題がある。 【0008】上記の問題を解決するためには、遮光膜を TFTアレイ基板側に作り込むことが効果的である。T FTアレイ基板の製造プロセスにおいて使用される歴光 マスクの合せ精度は容易に 14m以下にできるため、対 向基板とTFTアレイ基板との位置合わせずれを吸収す 30 ない。 るためのマージンを取らずともよくなり、開口率が改善 されるからである。

【0010】図5(a)は、遮光膜を作り込んだTFT アレイ基板の表示画素部分を示す平面図、図5(b)は そのA-B断面図である。なお、図5 (a) において斜 線の部分は、遮光膜によって覆われた部分を示してい

【0011】TFT501は、基板500上に配設され た第1のpoly-Siによる活性層503と、ゲート ート507からなる。ゲート507両側の部分はTFT 501のソース509・ドレイン511であり、n型ド ーパントであるP(燐)が打ち込まれて低抵抗となって いる。上記ドレイン511は第1の層間絶縁膜513を 挟んでAlからなる信号線515に接続されており、上 記ゲート507は第2のpoly-Siによるゲート線 517と一体である。以上の積層構造の上には第2の層 間絶縁膜519が形成されており、さらに、第2の層間 絶縁膜519の上に遮光膜521が形成・パタニングさ

縁膜523が形成されており、さらにその上に「TOか らなる画素電極525が形成・パタニングされている。 との画素電極525は、前記の第1の層間絶縁膜51 3、第2の層間絶縁膜519、第3の層間絶縁膜523 を通してTFT501のソース509に接続されてい る。 遮光膜 521はある一定電位を持つように電圧が印 加される。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の あり、位置合わせ精度をこれ以上にするのは極めて困難 10 ような構成のTFTアレイ基板では、画素電板525と 下層にあるTFT501のソース509とを接続する 際、これらの層間を接続するためのスルーホール527 を設けることによる層間の電気的短絡を避けるために、 その中間層にあたる遮光膜521に開口を設けておく必 嬰がある。 これは比較的導電性の高い画素電極525と 遮光膜521とが電気的に接触することを防ぐためであ る。 遮光膜 521は、そのスルーホールを避けるための 開口を設けねばならないが、その開口の面積は、製造の 際の位置ずれを考慮しその位置ずれを吸収できるクリア 基板側と対向基板側で熱による膨脹および伸縮の度合い 20 ランスを取って大きめに設定しなければならない。具体 的には、スルーホール527、遮光膜521、画素電極 525など各層のフォトリングラフィ工程におけるエッ チングなどによる位置ずれを考慮しなければならない。 例えば画素電極525と下層にあるTFT501のソー ス509が配設された第1のpoly-Si層を接続す るために第1の層間絶縁膜513および第2の層間絶縁 膜519に穿設するスルーホール527の大きさを 5μ 血角とすると、遮光膜521の閉口はマスク擦れ、エッ チング精度を考慮すると10μm角以上としなければなら・

> 【0013】その結果、上記の関口から光が漏れてしま い、遮光膜としての機能が十分ではなくなるという問題 がある。また、前記の開口の面積だけ補助容量の面積が 小さくなるので、形成可能な補助容量の値が小さくな り、画像の品位が低下するという問題がある。 【0014】本発明は、このような問題を解決するため

に成されたもので、その目的は、液晶表示装置の製造時 に生じる位置ずれを吸収するための寸法マージンを取る ことによる遮光膜の隙口率の低下の問題や、表示にとっ 絶縁膜505、低抵抗の第2のpoly-Siによるゲ 40 て不要な開口の面積を大きく取らねばならないことによ る光の遅れの問題を解消して、輝度が高く表示品位の良 好な液晶表示装置を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、基板上に複数の走査配線および複数の信号配線と、 設走査配線および信号配線に接続されるスイッチング素 子と、酸スイッチング素子に接続される固素電極と、前 記画素電極を避けて配設され前記スイッチング素子に入 射する光を遮る遮光膜とを有するスイッチング素子アレ れている。さらに、遮光膜521の上には第3の層間絶 50 イ基板と、前記スイッチング素子アレイ基板に対向して

(4)

間隙を有して配置される対向電極が配設された対向基板 と、前記スイッチング素子アレイ基板と前記対向基板と の間に封入される液晶組成物とを有する液晶表示装置に おいて、前記遮光膜が金属材料からなり、前記遮光膜の 上層を酸化してなる絶縁膜を具備することを特徴として いる。 また、本発明の液晶表示装置の製造方法は、基 板上に複数のゲート配線と複数の信号配線と該走査配線 および信号配線に接続するスイッチング素子と、該スイ ッチング素子に接続する画素電極とを配設し、少なくと も前記ゲート配線または前記信号配線または前記スイッ 10 の外向面 (主面側) には、その遮光膜23の表面自体を チング素子に入射する光を遮るように遮光膜を配設し、 前記遮光膜上に絶縁膜を配設してスイッチング素子アレ イ基板を形成し、これを対向電極と組み合わせてその間 隙に液晶組成物を封入して挟持させ、液晶表示装置を製 造するにあたり、金属材料を成膜して前記遮光膜を形成 し、前記遮光膜の上層を陽極酸化により酸化して絶縁膜 を形成することを特徴としている。 なお、進光膜の材 質としては、Ta、Cr、Ti、Wなどの高融点金属や A 1 などが好適である。

[0016]

【作用】遮光膜を隔極酸化して絶縁膜とすることによ り、製造工程を簡易化することができ、かつ画素部分の 開□率を向上することができる。

【0017】また、陽極酸化法により形成された絶縁膜 はピンホールが極めて少ないので、この絶縁膜の上層に 形成される画素電極およびとの絶縁膜の下層の遮光膜と の電気的接触の危険性を低減させることができる。

【0018】また、スルーホール用の遮光膜の開口を広 げることなくTFTアレイ基板が製造できるため、前記 画素電極の開口率が小さくなることによる画面の輝度の 低下などの問題を解消することができる。

[0019]

【実施例】以下、本発明の液晶表示装置の実施例を、図 面に基づいて詳細に説明する。

(実施例1)図1は、本発明に係る第1の実施例の液晶 表示装置における、表示画素部分を示す断面図である。 説明の簡略化のために、特にTFTアレイ基板を中心に

【0020】 この第1の実施例の液晶表示装置の表示画 40 る。 素部分は、次のように構成されている。石英基板上1 に、第1のpoly-Siによる活性層3と、ゲート絶 緑膜5と、低抵抗の第2のpoly-Si膜からなるゲ ート7と、ゲート7下の活性層3の左右にそれぞれ配設 されたソース9およびドレイン11とからその主要部が 構成されるTFT素子12が形成されている。その上を 覆うように、SiO」からなる第1の層間絶縁膜13が 形成され、上記ドレイン11部分に第1の層間絶縁膜1 3の外部から電気的接続を取るためのスルーホール15

ルーホール15でドレイン11に接続されている。 第2 の層間絶縁膜19が第1の層間絶縁膜13および信号線 17を覆うように形成され、活性層3のソース9側の端 部に達するスルーホール21がゲート絶縁膜5、第1の 層間絶縁膜13、第2の層間絶縁膜19を貫通して形成 されている。さらにTa膜からなる遮光膜23が、画素 部分を選け、かつTFT素子12などを遮光するような 形状の、いわゆるブラックマトリックスとして、第2の

層間絶縁膜19上に形成されている。そして遮光膜23

【0021】そしてITOからなる画素電極27がその 第3の層間絶縁膜25の上層として形成されている。と の画素電極27は前記のスルーホール21で活性層3に 接続されソース8に接続されている。

酸化してなる第3の層間絶縁膜25が形成されている。

【0022】次に、本実施例の液晶表示装置の製造方法 を、画素部分を中心に説明する。

【0023】石英墓板上1に、第1のpoly-Siに よる活性層3と、ゲート絶縁膜5と、低抵抗の第2のp 20 01 y-Si膜からなるゲート7と、ゲート7下の活性 層3の左右にそれぞれ配設されたソース9 およびドレイ ン11とからその主要部が構成されるTFT素子12を 形成する。

【0024】第1のpoly-Siおよび第2のpol y-Siは減圧CVD法により形成し、ゲート絶縁膜5 は熱酸化法により形成する。

【0025】ゲート7は第2のpoly-Si膜をエッ チングして形成する。つまりゲート線(図示省略)と同 一の膜で一体形成する。ゲート7下の活性層3の左右両 の開口により補助容量が小さくなるという問題や、表示 30 側の部分はTFT索子12のソース9 およびドレイン1 1であり、n型ドーパントであるP(燐)をイオン注入 法により打込んで低抵抗領域としている。

> 【0026】次に減圧CVD法により、SiO.からな る第1の層間絶縁膜13を形成し、上記ドレイン11部 分に第1の層間絶縁膜13の外部から電気的接続を取る ためのスルーホール15を穿設する。引続きA1膜をス パッタにより成膜した後、エッチングして所望の形状に パターンニングし信号線17を形成する。この信号線1 7は前記のスルーホール15でドレイン11に接続され

> 【0027】次に常圧CVD法により第2の絶縁膜19 を形成し、活性層3のソース9側の端部にまで達するス ルーホール21を形成する。

> 【0028】引き続き、遮光膜23としてTa膜をスパ ッタ法により成膜後エッチングによりパタニングして所 定の形状のブラックマトリックスに形成する。

【0029】続いて上記Ta膜からなる所定の形状の遮 光膜23を陽極としてこれに電圧を印加し、遮光膜23 の外向面(主面側)を陽極酸化して第3の層間絶縁膜2 が穿設されている。A1からなる信号線17が前記のス 50 5を形成する。本実施例においては、遠光膜23は画素

(5)

に対応する部分に開口を有してひとつながりの形状のた め、その一端に陽極酸化用電源を接続して、クエン酸溶 液中で陽極酸化を行なった。その陽極酸化の印加電圧は 100V、時間は60分で、とのとき形成された酸化膜の厚 さは1700オングストロームであった。 遮光膜23のスル ーホール用の開口は陽極酸化がTa膜内にも広がるた め、1000オングストローム程度拡がった。

【0030】引き続き「TOをスパッタ法により形成、 パターニングして画素電極27を形成する。このとき、 画素電極27は前記のスルーホール21で活性層3に接 10 気的に接触してしまうといった欠陥はさけることができ 続しソース9に接続される。

【0031】本実施例においては、第1の絶縁膜13、 第2の絶縁膜19に開けたスルーホールの大きさを 5μ m角とし、遮光膜23のスルーホール用の開口は前記5 μπ角に対し周辺を 1μπずつ広げ 7μπ角とした。 と の場合、画素電極27は遮光膜23と電気的に接触する ことなく、TFT素子12のソース9との接触を取るこ とができた。なお、遮光膜23のスルーホール用の開口 は、前述したように陽極酸化がTa膜内にも広がるため □率や補助容量の値にはほとんど影響はなく、精度良く 絶縁膜と遮光膜とを形成することができる。

【0032】(実施例2)上記の第1の実施例において は、ゲート配線・信号配線・スイッチングトランジスタ の一群と、遮光膜と、画素電極とが、この順にそれぞれ 絶縁体を挟んで積層形成されているアクティブマトリッ クス型液晶表示装置の場合について述べたが、本発明を 実施するには上記の構成に限らない。

【0033】図2は、第2の実施例に係るアクティブマ 面図である。

【0034】この第2の実施例の液晶表示装置は、石英 基板201直上にTaからなる遮光膜203が形成さ れ、遮光膜203、ゲート配線(図示省略)および信号 配線205およびTFT素子207の一群、画素電極2 06の順に、それらの層間にそれぞれ絶縁体209、2 29を挟んで積層形成されているように構成された液晶 表示装置である。

【0035】前記の遮光膜203の上層部にはTaを陽 極酸化してなる2000オングストロームの膜厚の絶縁膜2 40 13が形成されている。その上に常圧CVD法により成 膜されたSiO,膜215が形成されている。 さらにそ の上に第1のpoly-Siによる活性層217と、ゲ ート絶縁膜219、低抵抗の第2のpoli-Siによ るゲート221からなるTFT素子207が形成されて いる。ゲート221下の活性層217の両槽の部分はT FT索子207のソース223、ドレイン225であ り、n型ドーパントであるP(燐)がイオン注入法によ り打込まれて低抵抗となっている。さらにその上層に層

記ドレイン225部分にA1からなる信号線205が形 成され、スルーホール227を通してドレイン225に 接続されている。その上層には第2の絶縁膜229が形 成されている。さらにITOからなる画素電極208が 形成されており、スルーホール231にてソース223 に接続されている。

【0036】このような第2の実施例の液晶表示装置に おいては、遮光膜203と他の導電体からなる層とがス ルーホールの位置ずれ(バターンずれ)などによって電 るものの、遮光膜203と他の導電体とがピンホール欠 陥によって電気的に接触してしまうという場合がある。 しかし、本発明では、ピンホールの極めて少ない陽極酸 化膜を用いているので、そのようなピンホール欠陥など の、膜の欠陥の発生を抑えることができる。

【0037】なお、上記の実施例では、遮光膜としてT aを用いる場合について述べたが、これには限定しな い。Cr、Ti、Wなどの高融点金属、あるいはAlを 用いることも可能である。その際、陽極酸化工程に用い 1000オングストローム程度広がるものの、表示画素の開 20 る溶液も前述のクエン酸に限らず、それぞれの金属に適 した溶液を用いることはいうまでもない。遮光膜用の金 属材料としては、光透過率が小さいことから一般的には Cr、Ta、Ti、▼などのいわゆる高融点材料が用い られるが、これらの高融点材料は酸化性が強く、例えば 低圧CVD法や常圧CVD法によりSiO、膜を金属膜 表面に堆積しようとしても、金属全体が急速に酸化して しまい、可視光範囲で透明になってしまい、遮光膜とし ての機能を果さなくなるというという問題がある。これ らの高融点材料は、 400°C以上では10ppmの酸素があ トリックス型の液晶表示装置の画素部分の構成を示す断 30 ると酸化されてしまう。したがってこれらの高敵点材料 上に絶縁膜を形成しようとすると、低温下での成膜が可 能なプラズマCVD法によらねばならないが、プラズマ CVD法により得られる膜は、周知のようにパーティク ルが多くピンホールも多いため、その胰品質が低いとい う問題がある。しかしながら本発明によれば、陽極酸化 された遮光膜の上に減圧CVD法や常圧CVD法により Si〇、膜を形成することが可能であり、あるいはSi O、膜を形成せずとも直接TFT素子の活性層となるp oly-Si膜を形成することもできる。

> 【0038】また、上記の第2の実施例に示すような構 成の液晶表示装置では、SiO、膜215は省略あるい は代替が必ずしも不可能ではない。Si〇、膜215 は、遮光膜203とTFT207との間のこのように2 層構造として層間絶縁膜を厚くするために配設したもの である。この意味では、絶縁膜213を層間絶縁膜とし て膜厚が比較的厚めな膜とすれば 1層構造としてもよ

【0038】また、上記の実施例においては、遮光膜が 開口を有しながらもひとつながりの形状となっている場 間絶縁膜209としてSiO、膜が形成されており、上 50 合について説明したが、遮光膜のパターンはこれには限 (6)

定しない。例えば各画業ととに分割された形状の遮光膜 にも本発明の技術を用いることができる。ただしこの場 合、各画素ととに分割された一つ一つの進光膜をなんら かのブリッジパターンのようなもので接続し、その一端 に電圧を印加するなどの方策を加える必要があるもの の、ほぼ上記の実施例と同様の方法で陽極酸化を行なう ととができる。

[0040]また、上記の第1および第2の実施例で は、nチャンネルのpoly-SiTFTについて述べ てきたが、pチャンネルのpoly-SiTFTを画素 10 す図。 のスイッチングトランジスタとして用いたときにも有効 である。さらに、poly-SiTFTに限らず、スタ ガ型のa-SiTFTを画素のスイッチングトランジス タとして用いることもできる。

[0041]

【発明の効果】以上、詳細な説明に明らかなように、本 発明によれば、液晶表示装置の製造時に生じる位置ずれ を吸収するための寸法マージンを取ることによる遮光膜 の開口率の低下の問題や、表示にとって不要な開口の面 積を大きく取らねばならないことによる光の漏れの問題 20 光膜、25…第3の層間絶縁膜、27…画素電極 を解消して、輝度が高く表示品位の良好な液晶表示装置*

*を提供することができる。また、そのような液晶表示装

置の製造方法、特に遮光膜および絶縁膜の工程を簡易な ものとすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の表 示画素部分の構造を示す平面図。

【図2】本発明の第2の実施例に係る液晶表示装置の表 示画素部分の構造を示す平面図。

【図3】従来の液晶表示装置の表示画素部分の構造を示

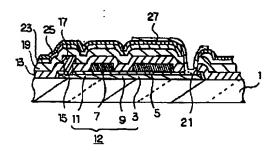
【図4】液晶表示装置のTFTアレイ基板およびと対向 基板を示す一部省略斜視図。

【図5】 遮光膜がTFTアレイ基板側に形成された従来 の液晶表示装置の表示画素部分を示す図。

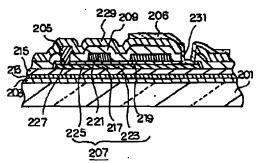
【符号の説明】

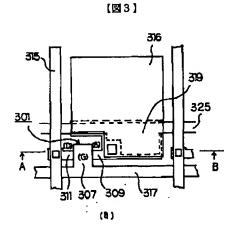
1…石英基板、3…活性層、5…ゲート絶縁膜、7…ゲ ート、9…ソース、11…ドレイン、12…TFT素 子、13…第1の層間絶縁膜、15、21…スルーホー ル、17…信号線、19…第2の層間絶縁膜、23…遮

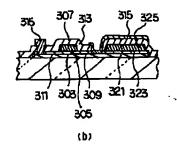
[図1]

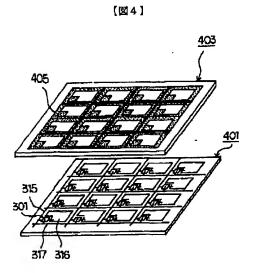


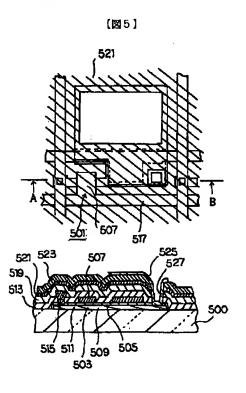
【図2】











特開平6-11728

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成13年4月27日(2001.4.27)

【公開番号】特開平6-11728

【公開日】平成8年1月21日(1994.1.21)

【年通号数】公開特許公報6-118

【出願番号】特願平4-170761

【国際特許分類第7版】

G02F 1/136 500

[FI]

GO2F 1/136 500

【手続補正書】

[提出日] 平成11年6月25日(1999.6.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】

薄膜トランジスタ、液晶表

示装置、および液晶表示装置の製造方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に複数の走査配線および複数の信号配線と、設走査配線および信号配線に接続されるスイッチング素子と、酸スイッチング素子に接続される画素電極と、前配スイッチング素子アレイ基板と、前配スイッチング素子アレイ基板と、前配スイッチング素子アレイ基板に対向して間隙を有して配置される対向基板と、前記スイッチング素子アレイ基板と前記対向基板との間に封入される液晶組成物とを有する液晶表示装置において、

前記遮光膜が金属材料からなり、前記遮光膜の<u>表面</u>を散化してなる絶縁膜を具備することを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項2】 基板上に複数の<u>走査配線</u>と複数の信号配線と複数の信号配線と<u>較走査配線</u>および信号配線に接続するスイッチング素子と、酸スイッチング素子に接続する画素電極とを配設し、前配スイッチング素子に入射する光を遮る金属材料からなる遮光膜を配設し、前配遮光膜上に絶縁膜を配設してスイッチング素子アレイ基板を形成し、これを<u>対向基板</u>と組合せてその間隙に液晶組成物を封入して挟持させ<u>る液晶表示装置の製造方法</u>において、

前配遮光膜の<u>表面</u>を陽極酸化により酸化して絶縁膜を形成する<u>工程を含む</u>ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【簡求項3】 チャネル、ソースおよびドレインを有する活性層と、前記チャネルに対応して形成されたゲート電極と、前記活性層と前記ゲート電極との間に形成されたゲート絶縁膜と、少なくとも前記チャネルに入射する光を遮る遮光膜と、を同一基板上に有する薄膜トランジスタにおいて、

前記遮光膜は、金属材料からなり、前記遮光膜の表面に 前記金属材料を酸化させてなる絶縁膜を有するととを特 徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項4】 前記基板は透光性を有し、前記基板上に 前記遮光膜および前記絶縁膜が形成され、との上に、前 記活性層、前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極がと の順に形成されていることを特徴とする請求項3記載の 薄膜トランジスタ。

【<u>請求項5</u>】 前記活性層は、多結晶シリコンを主成分とすることを特徴とする請求項4記載の薄膜トランジス々

【<u>請求項8</u>】 前記滅光膜と前記活性層との間には、前 記絶縁膜とさらに他の絶縁膜が形成されていることを特 徴とする請求項3記載の薄膜トランジスタ。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

[0015]

【課題を解決するための手段】 本発明の液晶表示装置は、基板上に複数の走査配線および複数の信号配線と、該走査配線および信号配線に接続されるスイッチング素子と、該スイッチング素子に接続される画素電極と、前記スイッチング素子に入射する光を遮る遮光膜とを有するスイッチング素子アレイ基板と、前記スイッチング素子アレイ基板と、前記スイッチング素子アレイ基板に対向して配置される対向基

特開平6-11728

板と、前記スイッチング素子アレイ基板と前記対向基板 との間に封入される液晶組成物とを有する液晶表示装置 において、前記遮光膜が金属材料からなり、前記遮光膜 の表面を酸化してなる絶縁膜を具備することを特徴とし ている。また、本発明の液晶表示装置の製造方法は、基 板上に複数の走査配線と複数の信号配線と複数の信号配 線と該走査配線および信号配線に接続するスイッチング 素子と、該スイッチング素子に接続する画素電極とを配 設し、前記スイッチング素子に入射する光を遮る金属材 料からなる遮光膜を配設し、前記遮光膜上に絶縁膜を配 設してスイッチング素子アレイ基板を形成し、これを対 向基板と組合せてその間隙に液晶組成物を封入して挟持 させる液晶表示装置の製造方法において、前配遮光膜の 表面を陽極酸化により酸化して絶縁膜を形成する工程を 含むことを特徴としている。さらに、本発明の薄膜トラ ンジスタは、チャネル、ソースおよびドレインを有する

活性層と、前記チャネルに対応して形成されたゲート電極と、前記活性層と前記ゲート電極との間に形成されたゲート絶縁膜と、少なくとも前記チャネルに入射する光を遮る遮光膜と、を同一基板上に有する薄膜トランジスタにおいて、前記遮光膜は、金属材料からなり、前記遮光膜の表面に前記金属材料を酸化させてなる絶縁膜を有することを特徴としている。本発明の薄膜トランジスにおいて、前記基板は透光性を有し、前記基板上に前記性層、前記ゲート絶縁膜が形成され、この上に、前記活性層、前記ゲート絶縁膜が形成され、この上に、前記活性層、前記ゲート絶縁膜が形成され、この上に、前記活性層に、多結晶シリコンを主成分としている。さらに、前記述光度と前記活性層との間には、前記絶縁膜とさらに他の絶縁膜が形成されている。なお、遮光膜の材質としては、Ta、Cr、Ti、Wなどの高融点金属やAlなどが好適である。